

文部科学省「次世代 IT 基盤構築のための研究開発」
高機能・超低消費電力スピndeバイス・ストレージ基盤技術の開発
平成 21 年度成果報告会のご案内

拝啓、皆様にはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

東北大学電気通信研究所では、平成 19 年度より、文部科学省「次世代 IT 基盤構築のための研究開発」のうち、「高機能・超低消費電力コンピューティングのためのデバイス・システム基盤技術の研究開発」の委託研究を実施しております。本プロジェクトは、スピンを操る技術をもとに、産学連携で研究開発を推進し、メモリ・ロジック回路、ストレージ等の高機能・超低消費電力コンピューティングのための基盤技術を開発することを目的としております。このたび本プロジェクトの平成 21 年度成果報告会を下記の通りに開催することと致しました。皆様にはぜひご出席の上、忌憚のないご意見、ご指導を賜りますようご案内申し上げます。

ご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、何卒ご出席のほどよろしくお願い申し上げます。 敬具

プロジェクトリーダー 東北大学電気通信研究所 大野英男

日時： 2010 年 3 月 15 日（月） 13:00～17:20

場所： 東北大学電気通信研究所附属ナノ・スピン実験施設 4 階 カンファレンスルーム

プログラム：

1. 開会の挨拶およびプロジェクト概要説明：大野英男（リーダー，東北大） 13:00-13:15
2. 『次世代高機能・低消費電力スピndeバイス基盤技術の開発』
 - 1) 成果概要：大野英男（サブリーダー，東北大） 13:15-13:25
 - 2) 高性能磁気トンネル接合材料・素子の開発：池田正二（東北大） 13:25-13:40
 - 3) 極微細スピndeバイス製膜・加工技術の開発：森田 正（アルバック） 13:40-13:55
 - 4) 次世代 3 端子スピndeバイス基盤技術の開発：白井正文（東北大） 13:55-14:10
 - 5) 積層フェリ自由層を用いたスピントルク磁化反転素子：伊藤顕知（日立） 14:10-14:25
 - 6) 高性能スピン材料および素子の開発：安藤康夫（東北大） 14:25-14:40
 - 7) TMR ロジックインメモリ回路技術とその応用：羽生貴弘（東北大） 14:40-14:55
 - 8) リコンフィギュラブルスピndeプロセス用
SPRAM 技術の開発：田中徹（東北大） 14:55-15:10
 - 9) シリコン CMOS 回路と集積化された MTJ 特性：遠藤哲郎（東北大） 15:10-15:25
~~~~~休憩~~~~~ 15:25-15:50
- 3 『超高速大容量ストレージシステムの開発』
  - 1) 成果概要：村岡裕明（サブリーダー，東北大） 15:50-16:00
  - 2) 超テラビット級記録方式の開発：青井 基（東北大） 16:00-16:15
  - 3) 高分解能ライトヘッドの開発：山川清志（東北大） 16:15-16:25
  - 4) ヘッド磁極の微細加工とエッチングダメージ：大沢裕一（東芝） 16:25-16:35
  - 5) 超高感度リーダ技術の開発：高橋宏昌（日立製作所） 16:35-16:50
  - 6) 次世代垂直記録媒体の開発：島津武仁，片岡弘康（東北大，富士電機） 16:50-17:05
  - 7) 新規省電力超高速サブシステムの開発：藤本和久（東北大） 17:05-17:20

4 閉会の挨拶

お問い合わせ： 東北大通研 島津武仁（[shimatsu@riec.tohoku.ac.jp](mailto:shimatsu@riec.tohoku.ac.jp), Tel: 022-217-5494）

大野裕三（[oono@riec.tohoku.ac.jp](mailto:oono@riec.tohoku.ac.jp), Tel: 022-217-5554）

URL： <http://www.spin-storage.riec.tohoku.ac.jp/>